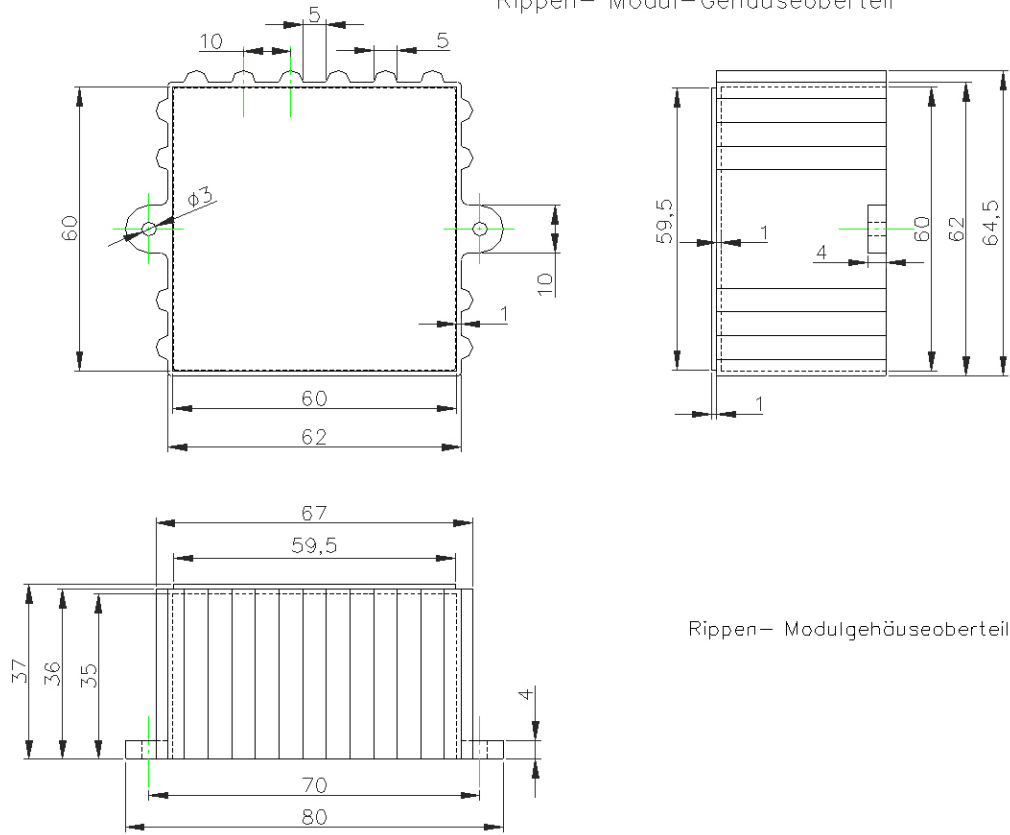


# Rippen- Modul-Gehäuseoberteil



Rippen- Modulgehäuseoberteil schwarz mit offenem Boden.

Gehäuse wird nach Einsetzen und Anschliessen der Platinen mit Giessharz verschlossen.

Verwendungsbereich		Zul Abw		Obarfil		Maßstab 1:1		Gewicht	
G007 Modul-Gehäuse mit Befestigungsloschen						Werkstoff Halbzugl  Thermoplast			
				Datum		Name			
		Bearb.		27.11.15		MSIMON		RIPPEN-MODULGEHÄUSE	
		Gepr.							
		Norm							
								G007	
								Blatt 1 von 1	
								Blätter	
Zust	Änderung	Datum	Name	KEMO-Electronic GmbH		Ersatz für.		Ersatz durch.	